

NUMBER 316516

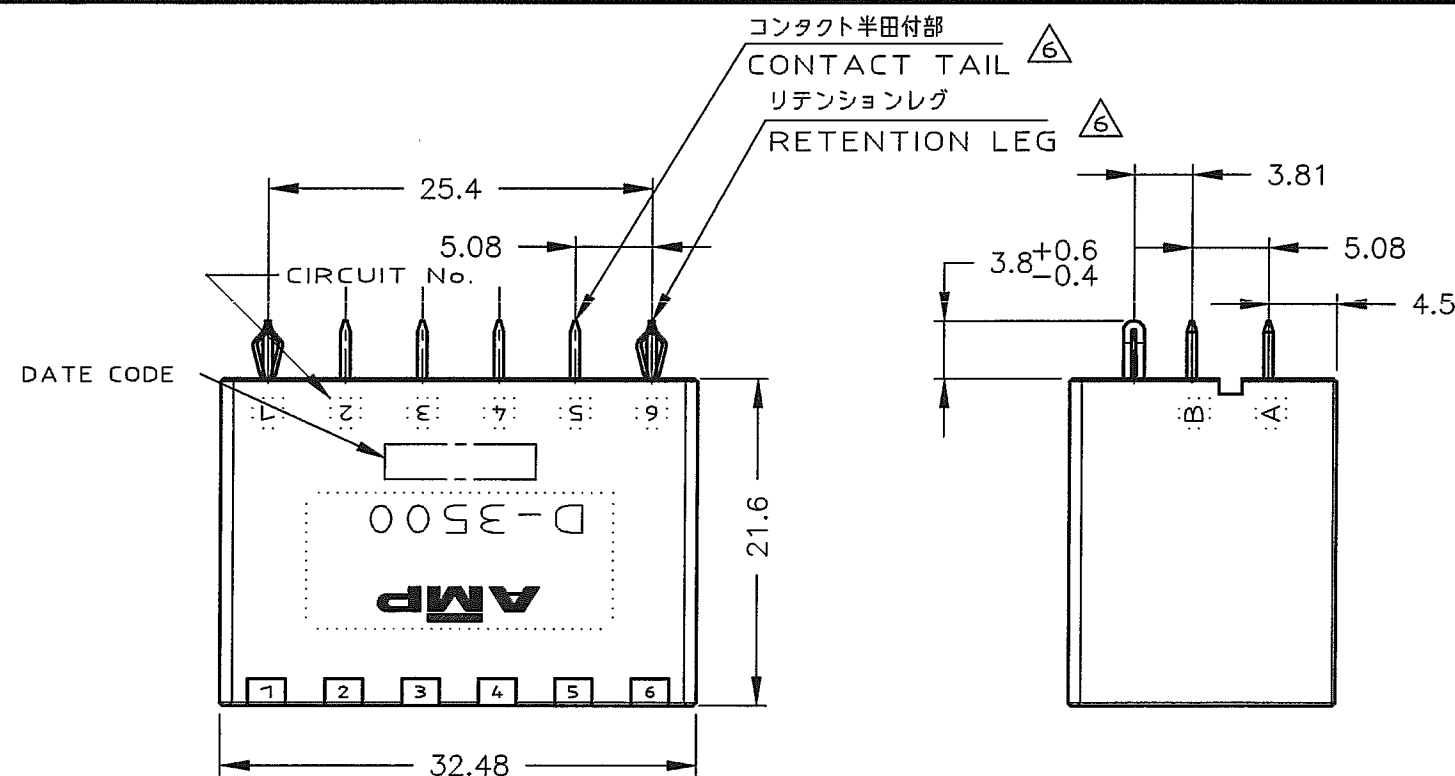


METRIC

PROJ NO.395-623

単位: 概 寸法 IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83

OUTLINE OF HEADER HSG.

ヘッダハウジング外形
ROUND DIA 3MIN. 2PLACES

ランド径最小3 2箇所

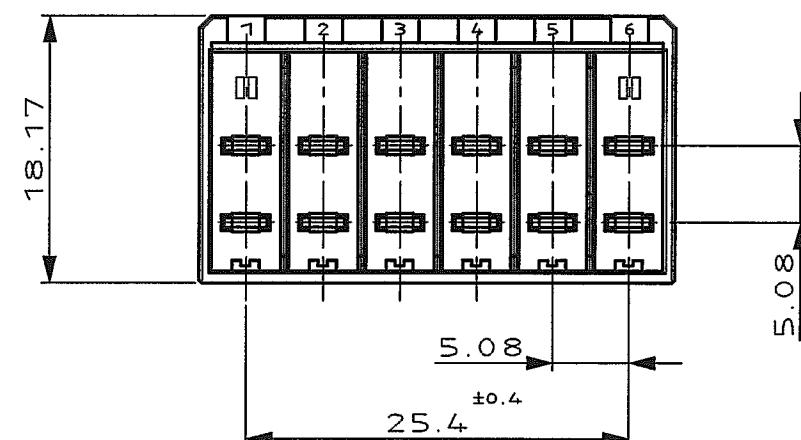
DIA 2±0.1 2PLACES

2±0.1穴2箇所

DIA 1.1±0.1 12PLACES

1.1±0.1穴12箇所

推奨基板取付け寸法 (非累積公差)
RECOMEND PC BOARD HOLE (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
基板厚: 1.6±0.1



NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, UL94V-0
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY

2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER NI PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注 記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性樹脂, UL94V-0
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金

2. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.38μm MIN
3. めっき: コンタクト接触部: ニッケル下地の上に金めっき 0.76μm MIN
4. めっき: コンタクト: 全面ニッケル下地 接触部: 2.0 μm MIN スズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	↑	-5
△6	△3		-3
△6	△2		316516-2
FINISH		型番	PART NUMBER

Copyright ©1995 年				Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				tyco Tyco Electronics AMP K.K. Electronics Kawasaki, Japan			
適合電線範囲 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)			
mm ² (AWG -)				mm ²				DYNAMIC (D-3500) 12 POS. V HDR. ASS'Y			
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照				仕上 (FINISH) (SEE NOTE) 注記参照				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		LOC	番号 (No.)
DR. 24 OCT 95 N.MATSUBARA				DE. 24 OCT 95 N.MATSUBARA				10mm以下 ±0.35 10mm以上 30mm以下 ±0.4 30mm以上 100mm以下 ±0.45 角 度: ±3°		A3	J
LTR 変更 (REVISION RECORD)				CHK. 24 OCT 95 Y.ISHIKAWA				尺 度 (SCALE)		REV.	SHEET
DR				APP. 24 OCT 95 S.MANABE				2/1		B	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[316516-3](#)